

半导体集成与封装中基于微观组织的多物理场耦合模拟

黄智恒^{①*}, 熊桦^①, 伍智勇^①, CONWAY Paul^②, DAVIES Hugh^③, DINSDALE Alan^③, 恩云飞^④, 曾庆丰^⑤

① 中山大学物理科学与工程技术学院, 广州 510275;

② Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, Loughborough, LE11 3TU, UK;

③ National Physical Laboratory, Teddington, TW11 0LW, UK;

④ 中国电子产品可靠性与环境试验研究所, 广州 510610;

⑤ 西北工业大学材料学院, 西安 710072

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(54\)](#)[相关文章 \(15\)](#)[点击分布统计](#)[下载分布统计](#)

版权所有 © 《中国科学》杂志社

地址: 北京市东黄城根北街16号, 《科学通报》编辑部, 100717

电话: 010-64036120 E-mail: csb@scichina.org

网络系统维护电话: 010-64034113 E-mail: sys@scichina.org